

LAPPING APPARATUS

Patent Number: JP58004353

Publication date: 1983-01-11

Inventor(s): OCHIAI YU'UJI; others: 02

Applicant(s):: HITACHI SEISAKUSHO KK

Requested Patent: JP58004353

Application Number: JP19810096723 19810624

Priority Number(s):

IPC Classification: B24B37 04

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To enable the adjustment of the positional relationship of a sample and a lapping surface plate, by making the same plane as the lapping surface plate as a detection reference, and detecting the inclination of the sample thereby correcting the inclination.

CONSTITUTION:The sample 5 attached to the tip of an arm 4 is positioned at the platen 6, and a laser beam from a laser beam source 10 is irradiated to the sample 5 through a collimator 11, a semi-transparent mirror 12 and an optical flat 13. Thus, if the sample 5 is inclined, interference will occur between the sample 5 and the optical flat 13 to yield interference bands. While observing the interference bands from the direction A, the arm 4 is swung up and down by operating a vertically driving mechanism (not shown) to correct the inclination of the sample 5. By setting the optical flat 13 and the surface plate 6 at the same height, the sample 5 becomes parallel with the platen 6. Thus, the positional relationship of the sample and the surface plate can be adjusted.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭58-4353

⑪ Int. Cl.³
B 24 B 37/04

識別記号

庁内整理番号
7610-3C

⑬ 公開 昭和58年(1983)1月11日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 3 頁)

⑭ ラッピング装置

① 特 願 昭56-96723
② 出 願 昭56(1981)6月24日
③ 発 明 者 落合雄二
横浜市戸塚区吉田町292番地株
式会社日立製作所生産技術研究
所内
④ 発 明 者 辻義一

小田原市国府津2880番地株式会
社日立製作所小田原工場内
⑤ 発 明 者 竹下孝二
小田原市国府津2880番地株式会
社日立製作所小田原工場内
⑥ 出 願 人 株式会社日立製作所
東京都千代田区丸の内1丁目5
番1号
⑦ 代 理 人 弁理士 薄田利幸

明 細 書

1 発明の名称 ラッピング装置

2 特許請求の範囲

回転又は揺動運動するラップ足盤とこの足盤
と同一面に横出歯車をもりけ、横出歯車と加工
試料との間の傾きを横出する機構と傾きを修正
できる機構とを具備したことを特徴とするラッ
ピング装置。

3 発明の詳細な説明

本発明は、試料の加工対象面とラップ足盤と
の相対位置関係を横出する機構を具備するラッ
ピング装置に関するものである。

鋳造ヘッド等の高精度部品の最終仕上げ加工に
はラッピング加工が従来より採用されている。
ラッピング加工は安価な装置で高精度の加工が
できることで古くから行なわれており、通常の
ラップ盤でフェライト材を加工しても、表面あ
らさ $0.02 \mu m R_m a x$ 以下、平直度 $0.5 \mu m / 20 mm$ 程度は
加工条件を満足することにより達成できる。し
かしながら、従来のラッピング加工はいかにし

て試料をラップ盤にならわせるかが主題である
ため、傾いて加工されたものを修正する能力を
もちあわせていない。このため、加工用器具に
工夫をこらせ、負荷圧力を場所により変化させ
傾きを修正する方法をとっていた。しかしこの
場合は負荷圧力の大きさと分布がむずかしく実
用的でない。そこで第1図に示す如く傾き修正
機構を具備したラッピング装置が考案された。
図において、ハンドル1を回すことにより上
下駆動機構2が上昇又は下降し、それとともに
ヒンジ3を介して連結しているアーム4を動か
す。アーム4の他端には試料5をとりつけ試
料5は回転又は揺動するラップ足盤6の上に設
置されている。このような状態のもとでハンド
ル1を操作することにより試料5とラップ足盤
6との接触する角が調整でき傾いて加工された
試料の修正が可能となる。

しかしながら、通常は生産性向上のため加工
も一段階でなく竟加工、中仕上げ、最終仕上げ
等の段階を踏むことが多い。この場合同一加工

傾で加工することはされて傾きが生ずることが普通である。旋削を施えると傾きの取付精度が向上する。旋削仕上げ加工は一般に表面性状を良くするため、細かい砥粒を用いて加工するため加工回数が多い。そのためできるかぎり加工取代は少ないことが好ましく取付けによる傾きを少なくする必要があるが、従来機は、取付け傾きを少なくできる機構を具備していない。

本発明は、上記した従来技術の欠点をなくし、試料とラップ定盤の位置関係を検出し、調整できる機構を具備したラッピング装置を提供するにある。

本発明は、試料の傾きを修正できる機構を有するラッピング装置においてラップ定盤と同一平面を有する検出系をもち、加工試料と検出部が接すべく移動させ、試料と検出部の相対位置を検出し、両者の2点あるいはそれ以上の検出点において差が一定値以下になるよう傾き修正位置により調整できるようにしたラッピング装置に関するものである。

レーザー光源10より発生したレーザー光はコリメータ11により平行かつ光束を拡げ半透鏡12を介し、オブティカルフラット13を通過し試料5とオブティカルフラット13間で干渉を生じ、干渉縞を形成し、4方向から目視できる。この干渉縞の状態を観察しつつ、上下駆動機構2を上下動させ試料5とオブティカルフラット13の間の平行を出す。オブティカルフラット13とラップ定盤6はあらかじめ、高さを等しく設定しておけば試料5とオブティカルフラット13の間の平行を出すことにより、試料5とラップ定盤6の間の平行も出せることがわかる。またオブティカルフラット13とラップ定盤6の間に隙があっても、あらかじめ調整しておくことにより補正できることは言うまでもない。

上記実施例では、平行度を検出する方法として、レーザー干渉を用いた方法について述べたがエアマイクロ計や、圧力センサーを用い試料の片持ち状態を検出することにより同様の検出ができることは明らかである。

具体的実施例につき図を用いて説明する。第1図はラッピング装置の主要部概略図、第2図は検出系に関する具体的実施例を示す。第2図において、ハンドル1を回転させることにより上下駆動機構2が上下動し、その量を検出部7により検出する。上下駆動機構2は一方向に回転自在のピンジョイントを介し、アーム4と連動しているアーム4の先端に試料5を取付ける。試料5はラップ用を供給した回転又は直線運動するラップ定盤6上に設置し一定加圧状態のもとで相対運動させ加工する機構となっている。さらに本装置においては、試料5をアーム4の先端にとりつけ、加工する前に試料5がラップ定盤6に対し傾いているか否かを検出する検出機構9を有する。検出機構9により、傾きが出た場合ハンドル1を操作することにより上下駆動機構2を上下動させ傾き量を少なくするよう調整する。次に検出機構9につき第3図を用いて説明する。本実施例はレーザー光による干渉縞を検出し傾きを調整する方法である。レ

本発明により、試料の傾きを修正できる機構を具備するラッピング装置において、試料とラップ定盤の間の傾き量を検出し、調整できることにより、試料の精度が容易となり、かつ傾き量を修正することにより、加工取代を少なくでき、加工時間は短縮できる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来技術を説明するラッピング装置の概略図、第2図は、本発明による具体的実施例を示す装置の主要部概略図、第3図は、本発明による具体的実施例を示す検出機構の概略図である。

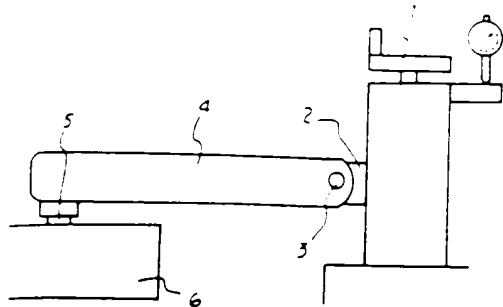
10…レーザー光源

11…コリメータ

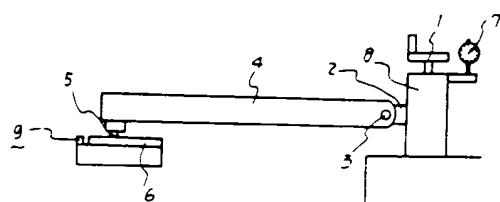
12…半透鏡

13…オブティカルフラット

第 1 圖



第 2 圖



第 3 圖

